



Since 1946
Brightening the Future

2023年度(2024年3月期) 第3四半期決算概要について

新光電気工業株式会社



目次

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2023年度 通期の見通し（連結）

売上高・損益・配当	11
設備投資額・減価償却費・研究開発費	13

JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ（12/12発表）	14
---	----

2024年3月期の期末配当予想の修正（無配）および株主優待制度の廃止に関するお知らせ（12/12発表）	15
---	----

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

決算概況

（単位：億円）

	2022年度 3 Q累計	2023年度 3 Q累計	前年同期比	
				増減率
売上高	2,325	1,566	△759	△33%
営業利益 (営業利益率)	712 (31%)	180 (11%)	△532	△75%
経常利益 (経常利益率)	729 (31%)	197 (13%)	△532	△73%
純利益※ (純利益率※)	505 (22%)	134 (9%)	△371	△74%

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益	373.85円	99.04円
-------------	---------	--------

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

概況

- 半導体業界は、緩やかな需要回復が見られるものの、世界的なインフレの継続や米国による対中半導体輸出規制をはじめとする地政学リスクの影響に加え、パソコン、サーバー市場の低迷継続や、買い替えサイクル長期化等によるスマートフォン需要の減少、在庫調整などにより、市況回復が遅れ、厳しい環境が継続。
- 当社グループにおいては、フリップチップタイプパッケージは、パソコン・サーバー需要の回復の遅れ等により売上が大きく減少。半導体製造装置向けセラミック静電チャックは半導体輸出規制に加え、市況悪化の影響を受け、リードフレームは在庫調整を背景に減収となるなど、総じて市況低迷の影響を受けた。
- 前年同期比で売上高33%減、売上高減少の影響を大きく受け、各利益とも減少。

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2022年度 3Q累計		2023年度 3Q累計		前年同期比 増減率 (%)	2022年度	
			構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
売上高 ※1	プラスチックパッケージ	1,446	(62)	965	(62)	△33	1,768	(62)
	メタルパッケージ	799	(34)	541	(34)	△32	993	(35)
	その他	80	(4)	61	(4)	△24	102	(3)
	合計	2,325	(100)	1,566	(100)	△33	2,864	(100)
経常利益 ※2			経常利益率(%)		経常利益率(%)			経常利益率(%)
	プラスチックパッケージ	457	(32)	92	(10)	△80	473	(27)
	メタルパッケージ	271	(34)	116	(21)	△57	312	(31)
	その他/調整額	1		△11			2	
合計	729	(31)	197	(13)	△73	788	(28)	

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

財政状態、設備投資・減価償却費等

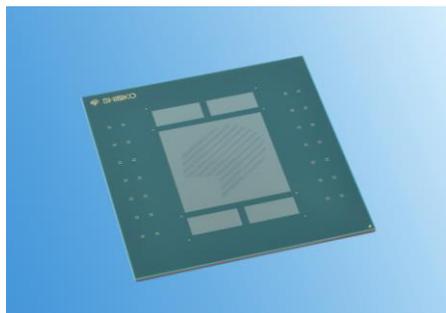
（単位：億円）

	2022年度3Q	2023年度3Q	2022年度
総資産	3,666	3,782	3,869
純資産	2,468	2,585	2,510
自己資本比率	67%	68%	65%

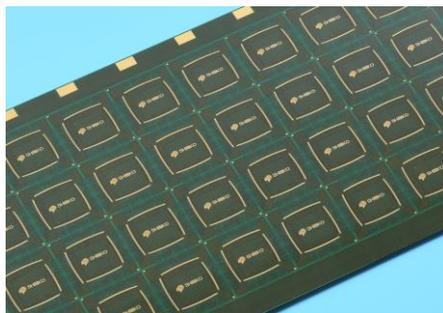
	2022年度3Q累計	2023年度3Q累計	2022年度
設備投資額※	202	282	258
減価償却費※	251	199	345
研究開発費	27	26	36
為替レート(1米ドル)	135円	141円	134円

※ 無形固定資産を除く

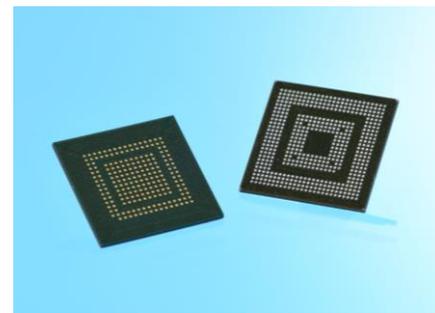
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

プラスチックパッケージ

（単位：億円）

	2022年度 3 Q累計	2023年度 3 Q累計	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	1,446 (62%)	965 (62%)	△481	△33%
経常利益（経常利益率）	457 (32%)	92 (10%)	△365	△80%

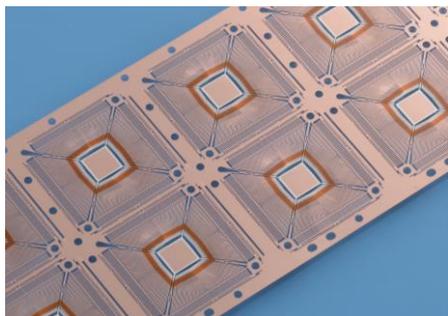
各製品の売上減少により、前年同期比で減収減益

- フリップチップタイプパッケージは、コロナ特需の反動などによるパソコン・サーバー需要の回復の遅れ等により、大幅な減収
- プラスチックBGA基板は先端メモリー向けが在庫調整の影響を受け、売上が減少
- IC組立はスマートフォン市場の低迷によりハイエンドスマートフォン向けの需要が減少し、売上が減少

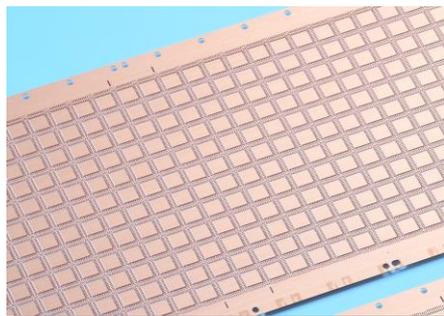


2023年度 第3四半期決算概要（連結）

メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

2023年度 第3四半期決算概要（連結）

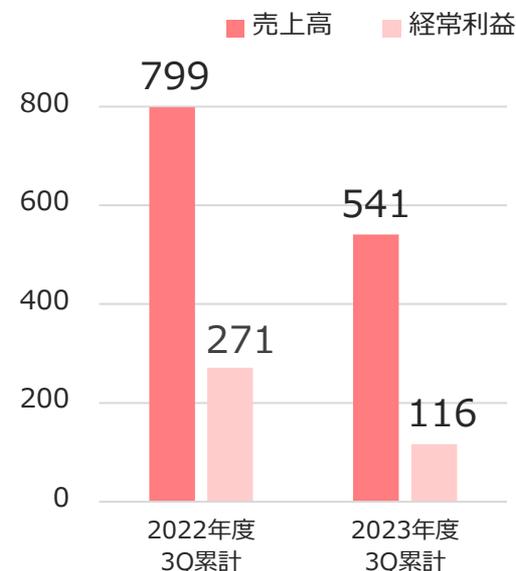
メタルパッケージ

（単位：億円）

	2022年度 3Q累計	2023年度 3Q累計	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	799（34%）	541（34%）	△259	△32%
経常利益（経常利益率）	271（34%）	116（21%）	△155	△57%

各製品の売上減少により、前年同期比で減収減益

- セラミック静電チャックは、米国による対中半導体輸出規制やメモリー市況悪化などの影響を大きく受け大幅な減収
- リードフレームは、半導体市況低迷による在庫調整等を背景に大幅な減収
- CPU向けヒートスプレッダーは、パソコン需要減退等の影響を大きく受け、売上が減少
- ガラス端子は、光学機器向けが低調に推移し売上が減少



2023年度 第3四半期決算概要（連結）

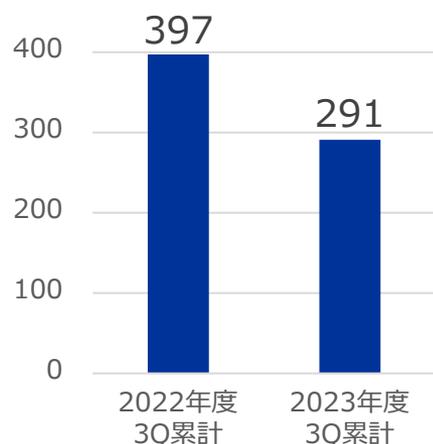
部門別売上高

（単位：億円）

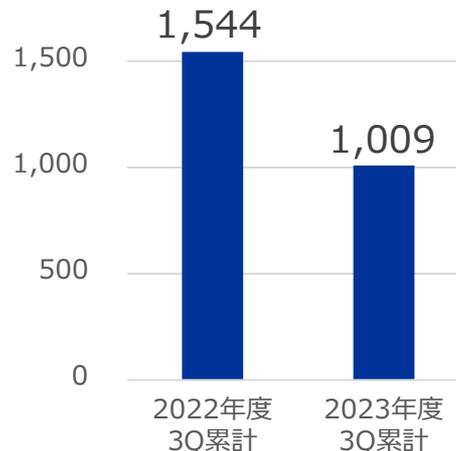
	2022年度 3Q累計	2023年度 3Q累計	前年同期比		2022年度
				増減率	
ICリードフレーム	397 (17%)	291 (19%)	△106	△27%	497 (17%)
ICパッケージ	1,544 (66%)	1,009 (64%)	△535	△35%	1,879 (66%)
気密部品	384 (17%)	266 (17%)	△118	△31%	487 (17%)

※（ ）は構成比

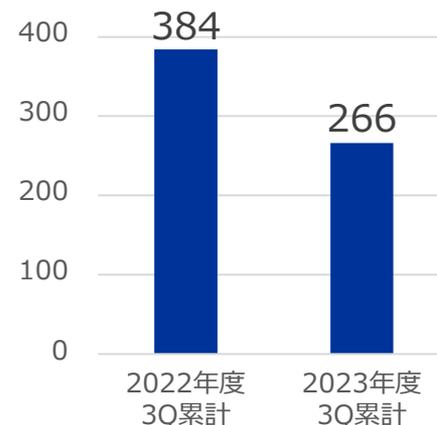
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



2023年度 通期の見通し（連結）

売上高・損益・配当

（単位：億円）

	2022年度（実績）			2023年度 （上期実績・下期予想）			前年同期比（上段：増減金額 下段：増減比率）		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高	1,570	1,294	2,864	1,051	1,249	2,300	△519 (△33%)	△45 (△3%)	△564 (△20%)
営業利益 (営業利益率)	510 (32%)	258 (20%)	767 (27%)	115 (11%)	235 (19%)	350 (15%)	△395 (△77%)	△22 (△9%)	△417 (△54%)
経常利益 (経常利益率)	546 (35%)	241 (19%)	788 (28%)	141 (13%)	209 (17%)	350 (15%)	△406 (△74%)	△32 (△13%)	△438 (△56%)
純利益※ (純利益率※)	379 (24%)	166 (13%)	545 (19%)	98 (9%)	142 (11%)	240 (10%)	△281 (△74%)	△24 (△14%)	△305 (△56%)
為替レート	134円/\$			第3四半期 実績 141円/\$	第4四半期 想定 135円/\$				

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

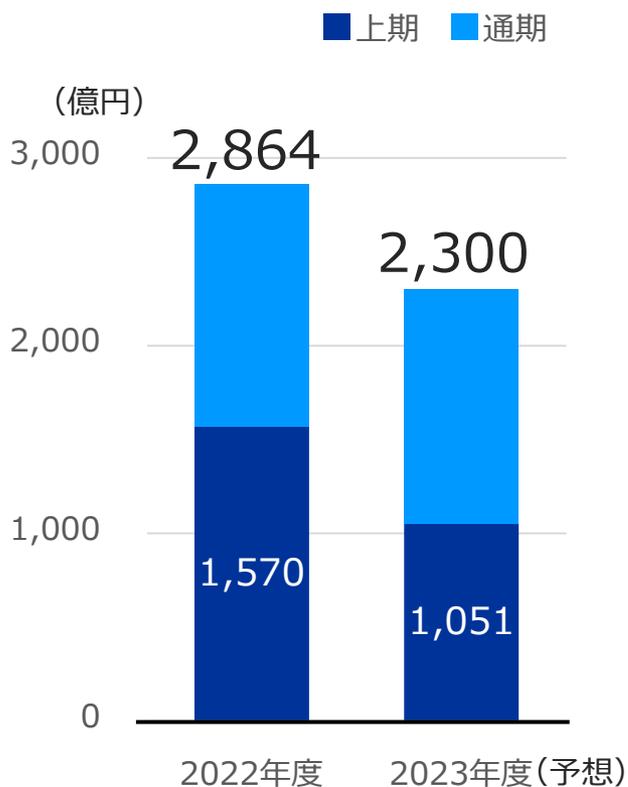
（単位：円）

1株当たり配当金 (配当性向)	25.0 [中間]	25.0 [期末]	50.0 (12.4%)	25.0 [中間]	0.0 [期末]	25.0 (14.1%)
--------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------

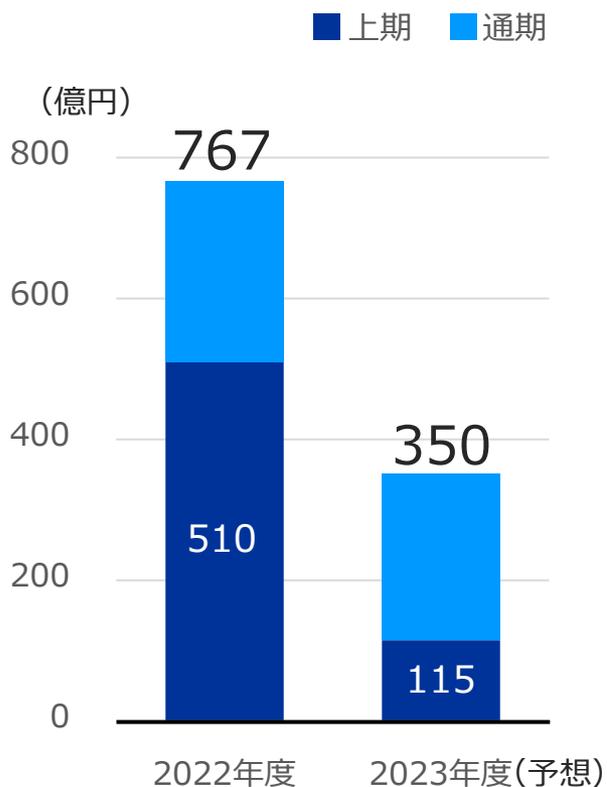
（注）2023年4月27日に公表いたしました2024年3月期の配当予想を修正し、期末配当を行わないことを決定しております。
15ページ記載の「2024年3月期の期末配当予想の修正（無配）および株主優待制度の廃止に関するお知らせ」をご参照ください。

2023年度 通期の見通し（連結）

売上高

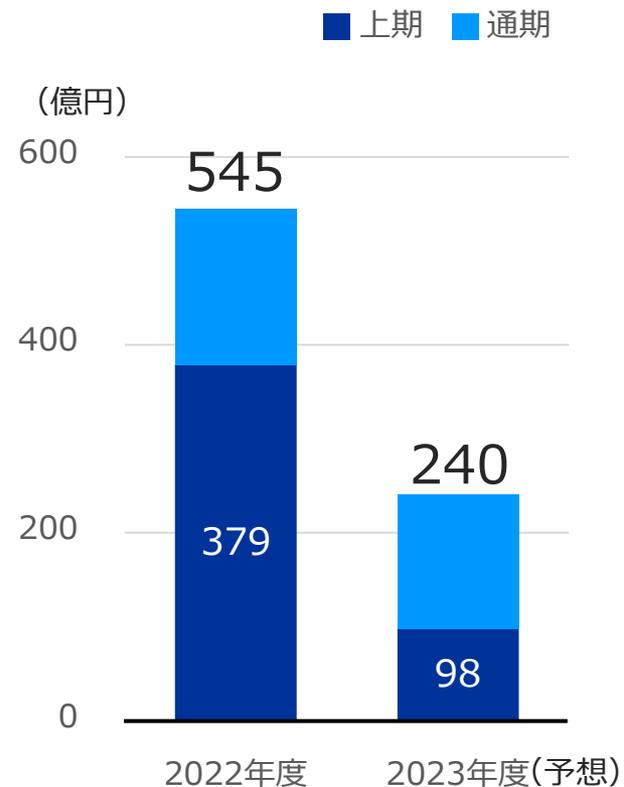


営業利益



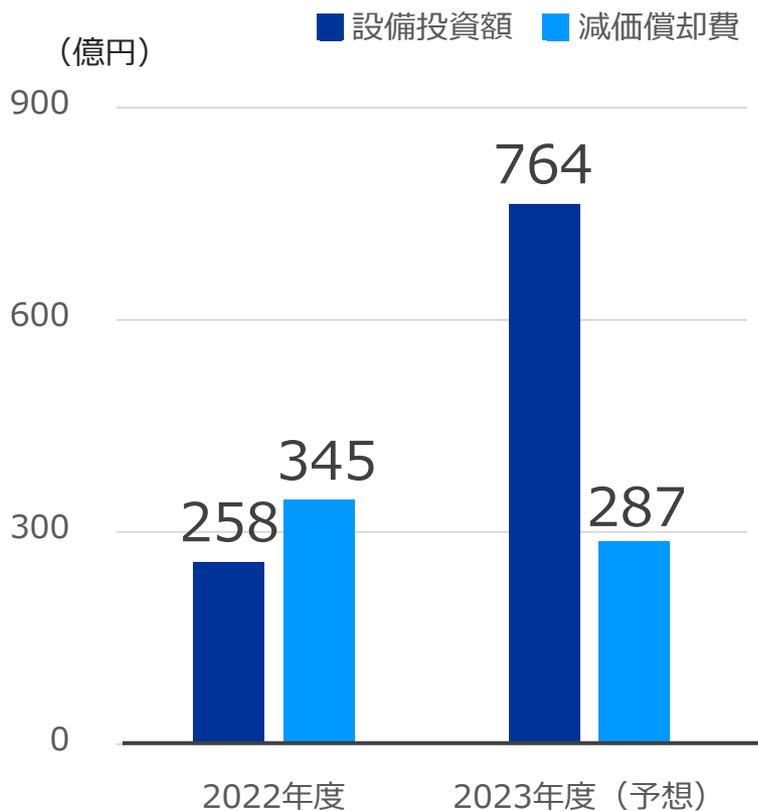
純利益※

※親会社株主に帰属する当期純利益

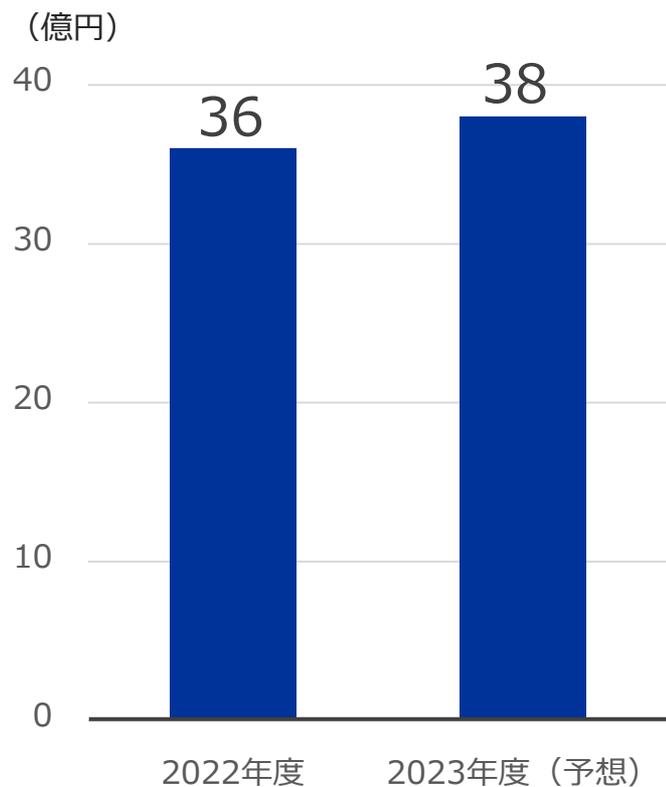


2023年度 通期の見通し（連結）

設備投資額・減価償却費



研究開発費



JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ 2023年12月12日発表（要旨）

当社は、2023年12月12日開催の取締役会において、JICC-04株式会社（JICキャピタル株式会社全額出資、以下「公開買付者」）による当社の普通株式（以下「当社株式」）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）に関して、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後に予定された一連の手続により、当社株式の全てを取得することを企図していること、および当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。

【本公開買付けの概要】

（1）買付け等の期間

本公開買付けは、国内外の競争法ならびに国外の投資規制法令等に基づく必要な手続および対応に一定期間を要することが想定されているため、本公開買付けの開始時期については、公開買付者により、2024年8月下旬が目指されてはいるものの、国外の競争当局および投資規制法令等を所管する当局における手続等に要する期間に影響されます。また、公開買付期間は20営業日となる予定です。

（2）買付け等の価格：普通株式1株につき、5,920円

（3）買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
67,530,488株	22,491,400株	－株

※本リリースの詳細は2023年12月12日発表の「JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」をご覧ください。

https://www.shinko.co.jp/news/docs/20231215_02.pdf

2024年3月期の期末配当予想の修正（無配）および株主優待制度の廃止に関するお知らせ 2023年12月12日発表（要旨）

当社は、2023年12月12日開催の取締役会において、JICC-04株式会社（JICキャピタル株式会社全額出資、以下「公開買付者」）による当社の普通株式（以下「当社株式」）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）が行われる予定であることをふまえ、2024年3月期の期末配当を行わないこと、および2024年3月期より株主優待制度を廃止することを決定いたしました。

1. 配当予想の修正

(1) 修正の内容

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	年 間
前回予想（2023年4月27日公表）	25円00銭	25円00銭	50円00銭
今回修正予想		0円00銭	25円00銭
当期実績	25円00銭		
（ご参考）前期実績（2023年3月期）	25円00銭	25円00銭	50円00銭

(2) 修正の理由

公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2024年3月31日を基準日とした配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、配当予想を修正し、2024年3月期の期末配当を行わないことを決議

2. 株主優待制度の廃止

当社株式に本公開買付けが行われる予定であることをふまえ、当該株主優待制度の廃止を決議

※本リリースの詳細は2023年12月12日発表の「2024年3月期の期末配当予想の修正（無配）および株主優待制度の廃止に関するお知らせ」をご覧ください。

https://www.shinko.co.jp/news/docs/20231212_02.pdf

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信または四半期報告書を参照していただきますようお願いいたします。